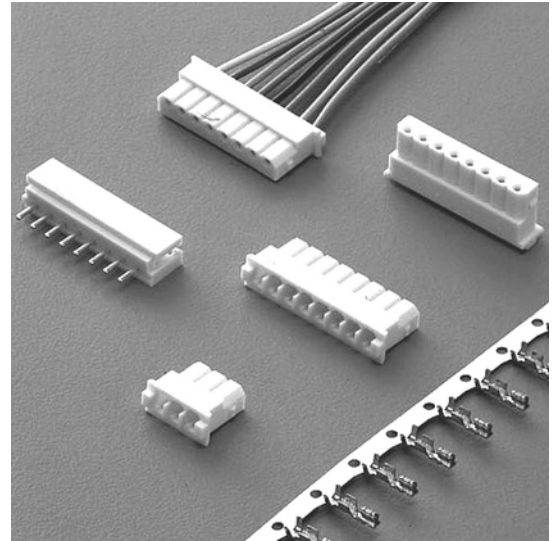


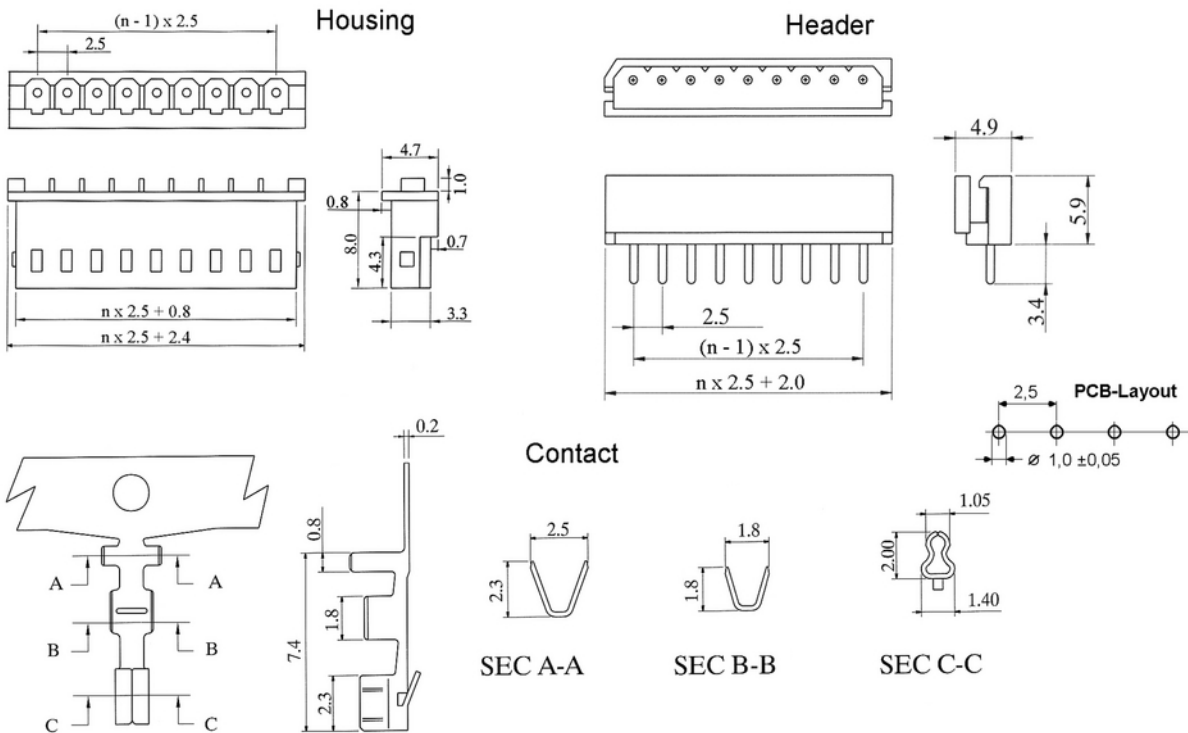
## Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,50mm, gerade Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.50mm Pitch, Straight

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 22 ... 28 <i>AWG 22 ... 28</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>AC</sub> <i>1kV<sub>AC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V <sub>AC</sub> <i>250V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C ... +85°C <i>-25°C ... +85°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Type*</b>	<b>Plating</b>
<b>575</b>	<b>15</b> 02-15	<b>3</b> 1 Buchsengehäuse <i>Housing</i> 2 Buchsenkontakte <i>Crimp contacts</i> 3 Stiftleiste gerade <i>Straight pin header</i>	<b>50</b> 50 Verzinkt (für Gehäuse nicht erforderlich) <i>Tin plated (not necessary for housings)</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*

